

Физико-технический  
институт им. А.Ф. Иоффе  
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию  
4 июля 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 18

26 сентября 1988 г.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОГРАММ  
С НАНОСЕКУНДНЫМИ ЭКСПОЗИЦИЯМИ  
НА ЭЛЕКТРОНОГРАФЕ ЭМР-100

Н.А. С а и н о в

Мощное импульсное лазерное излучение может вызвать фазовые переходы на поверхности кристаллов [1]. При этом, в принципе, могут образоваться кристаллические структуры, существующие только в момент действия импульса излучения. Для обнаружения таких структур необходимо развитие дифракционных методов структурного анализа с наносекундным и субнаносекундным временным разрешением. В настоящем сообщении описан метод получения электроно-грамм с наносекундными экспозициями.

Применяемые в электронографии экспозиции составляют обычно несколько секунд, следовательно, для получения достаточной плотности покрнения фотоэмulsionии в наносекундном диапазоне экспозиций необходимо повысить яркость дифракционной картины в  $\sim 10^8$  раз.

Повышение яркости достигнуто применением двух микроканальных пластин (МКП), расположенных друг за другом (рис. 1) и образующих "шевронную" конструкцию [2]. При приложении напряжения  $\sim 2.5$  кВ к блоку МКП за счет лавинообразного увеличения числа электронов в каналах пластин плотность потока электронов на выходе блока будет в  $\sim 10^8$  раз превышать плотность потока на входе.

За блоком МКП на расстоянии 1-2 мм располагается люминесцентный экран. Экран представляет собой волоконно-оптическую шайбу с осажденным слоем люминофора, который покрыт тонкой токопроводящей алюминиевой пленкой.

При приложении к зазору между экраном и блоком МКП ускоряющего напряжения 4-5 кВ на экране наблюдается усиленная по яркости дифракционная картина. Фотографирование производится контактным способом.

Питание блока МКП импульсное. Импульс длительностью  $\sim 1$  мкс формируется при разряде накопительной линии через искровой разрядник с лазерным поджигом. Экспозиция при фотографировании задается длительностью импульса напряжения, подаваемого на от-

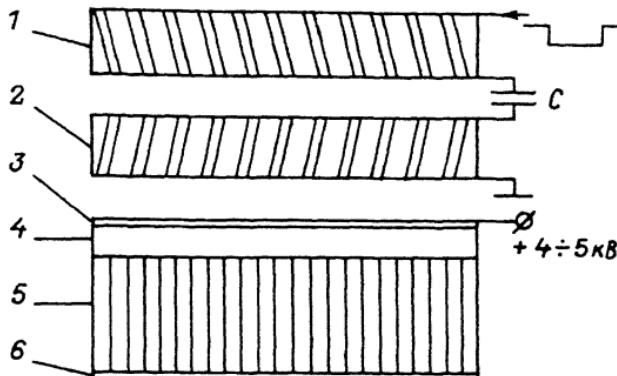


Рис. 1. Схема усилителя яркости. 1, 2 - МКП; С - корректирующая емкость; 3 - алюминиевая пленка; 4 - люминофор; 5 - волоконно-оптическая шайба; 6 - фотопленка.

клоняющие пластины затвора, расположенного в колонне электронографа.

Был выполнен следующий эксперимент. По методике, описанной в [3], регистрировалась кинетика изменения интенсивности одного из рефлексов электронограммы от образца монокристаллического кремния при действии на образец импульса излучения лазера ( $\lambda = 1.06 \text{ мкм}$ ,  $t = 35 \text{ нс}$ ,  $W \leq 3.5 \text{ Дж/см}^2$ ). По мере повышения энергии в импульсе происходил обратимый спад интенсивности рефлекса, а при превышении определенной энергии наблюдалось исчезновение сигнала. Следует отметить, что длительность отсутствия сигнала от рефлекса при этом равна длительности существования фазы с высоким коэффициентом отражения, наблюдаемого в оптических измерениях [4]. Затем производилось фотографирование рефлекса с экспозицией 50 нс, синхронизированной с импульсом излучения лазера.

На рис. 2 приведены фрагменты электронограммы с исследованным рефлексом. В отсутствие лазерного импульса наблюдается яркий рефлекс (рис. 2, г). При небольших энергиях в лазерном импульсе в момент его действия происходит ослабление яркости (рис. 2, д). Рефлекс отсутствует во время существования фазы с высоким коэффициентом отражения (рис. 2, е). То есть изменения, наблюдаемые на осциллограммах сигнала, обусловлены изменениями яркости рефлекса.

Если ослабление яркости рефлекса вызвано нагревом поверхности [5], то отсутствие рефлекса указывает на потерю дальнего порядка в структуре поверхности. То есть фаза с повышенным коэффициентом отражения представляет собой структурно-разупорядоченное (расплавленное) состояние.

Таким образом, применением двух МКП можно достичь усиления яркости электронограммы, достаточного для работы

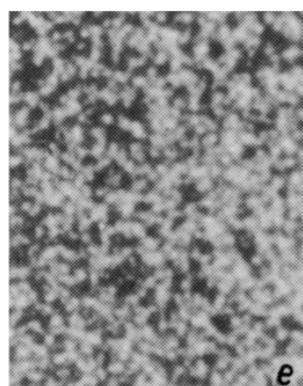
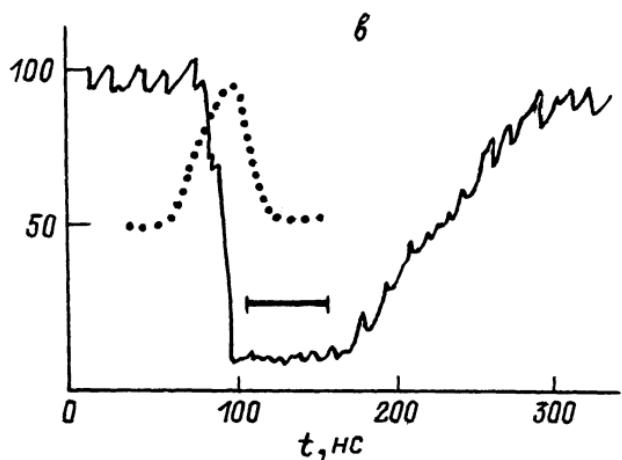
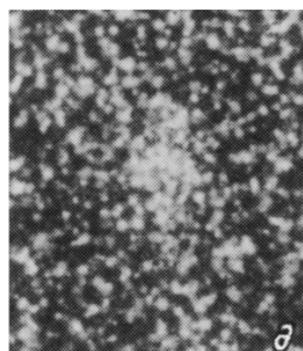
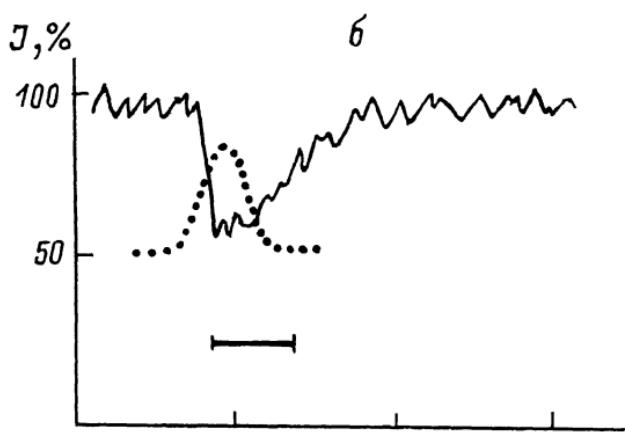
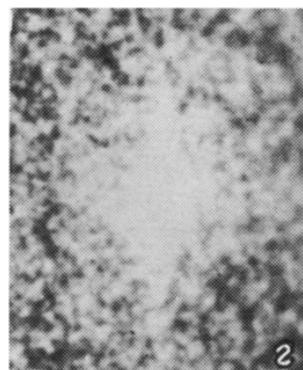
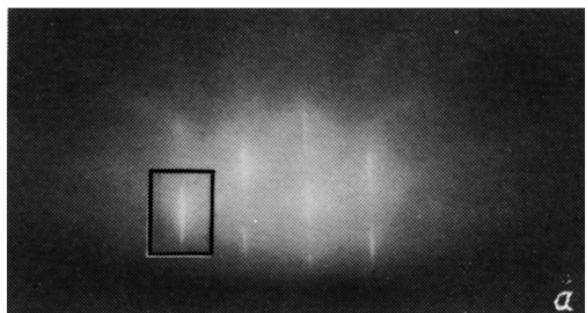


Рис. 2. Электронограмма от кремния, полученная в обычном режиме экспонирования (а); изображение выделенного на электронограмме рефлекса, полученное с экспозицией 50 нс (б); осциллограммы изменения интенсивности этого рефлекса при действии импульсов излучения разной энергии (в, г) и его изображения (д, е), полученные за интервалы времени, указанные на осциллографах отрезками линий. Пунктиром обозначен лазерный импульс.

с наносекундными экспозициями. Это позволит использовать электронограф ЭМР-100 для исследования быстропротекающих структурных изменений в различных объектах.

## Л и т е р а т у р а

- [1] Карпов С.Ю., Ковалевчук Ю.В., Погорельский Ю.В. – ФТП, 1986, т. 20, в. 11, с. 1945–1969.
- [2] Колсон У.В., Ферсон Дж., Кинг Ф.Т. – Приборы для научных исследований, 1973, № 12, с. 6–8.
- [3] Сайнин Н.А., Галяутдинов М.Ф., Хайбуллин И.Б., Штырков Е.И. – ПТЭ, 1982, № 3, с. 193.
- [4] Галяутдинов М.Ф., Сайнин Н.А., Хайбуллин И.Б., Штырков Е.И. В кн.: Тез. докл. У Все-союзн. совещ. по нерезонансному взаимодействию оптического излучения с веществом. 1981. 394 с.
- [5] Вайнштейн Б.К. Структурная электронография. М., 1956. 316 с.

Казанский  
физико-технический институт

Поступило в Редакцию  
14 июля 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 18

26 сентября 1988 г.

### НАБЛЮДЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЭФФЕКТА ДЖОЗЕФСОНА В ДЛИННЫХ МОСТИКАХ ИЗ КЕРАМИКИ $Y_1Ba_2Cu_3O_7$

Н.П. Герасимов, В.И. Кржимовский,  
А.С. Катков, С.В. Коzyрев,  
Е.И. Леонов, В.Ф. Мастеров,  
С.Э. Хабаров

Уже сообщалось о наблюдении нестационарного эффекта Джозефсона [1] в прижимных точечных контактах типа „игла – плоскость”: например, в [2] оба берега контакта были выполнены из керамики  $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-x}$ , в [3] игла из классического сверхпроводника ниобия прижималась к поверхности монокристалла состава  $Eu_1Ba_2Cu_3O_y$ . В обеих работах использовалось СВЧ-излучение с частотой  $f \sim 10$  ГГц.

В настоящей работе исследуются вольт-амперные характеристики (ВАХ) устройства, показанного на врезке рис. 1, состоящего из двух пластин керамики  $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-x}$  размером  $1.5 \times 2 \times 6$  мм<sup>3</sup>, приклеенных к слою изолятора толщиной порядка 30 мкм. Слабая связь была изготовлена скрабированием верхней пластины (толщина разреза 0.8 мм) и представляла собой длинный мостик [4]. Площадь сечения менялась углублением разреза (при этом контролиро-